

# W-GM-6200

## Wafer Edge Grinding Machine

- ウェーハサイズΦ 450 mm
- ベストセラー機 W-GM シリーズ
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- X 軸・Y 軸・ $\theta$  軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネルによる簡単操作



## W-GM-6200 仕様

基本仕様		
ウェーハサイズ		φ 450 mm
ウェーハの厚み		0.6 ~ 1.3 mm (標準)
ウェーハの形状		ノッチ
研削部		2 ステージ
外周加工用砥石形状	砥石溝径	φ 200 mm
	砥石外径	φ 202 mm
	内径	φ 30 mm
	フランジ厚み	20 mm
外周加工用砥石周速 (φ 202)		2500 m/min (最大)
研削スピード		外周部、オリフラ部、ノッチ部で個別に設定可能
外周加工用スピンドル		ビルトインモータ方式
操作パネル		15" カラー LCD タッチパネル
シグナルタワー		3 色表示灯
装置寸法		4250 (W) x 2900 (D) x 2600 (H) mm
装置重量		約 9000 kg
機構部仕様		
研削テーブル X, Y, Z 軸	分解能	1 μm
研削テーブル θ 軸	分解能	0.001°
	駆動方式	DD モータ
トランスファ部	搬送方式	吸着搬送 (上面)
洗浄部	洗浄方式	スピン洗浄
	乾燥方式	ドライエアー
供給部・収納部	方式	カセットキャリア
	カセット数	4 カセット (標準)
測定部仕様		
ウェーハ厚さ測定	分解能	1 μm
	繰り返し測定精度	± 2 μm 以内
	測定方法	非接触式
非接触式 アライメント機構	方式	グリーン LED 方式
	分解能	1 μm
	センタリング精度	± 35 μm 以内

## 株式会社東京精密

(本社) 〒192-8515 東京都八王子市石川町 2968-2  
 TEL: (042) 642-1701 FAX: (042) 642-1798  
<https://www.accretch.jp/>

お問い合わせ先

